組織委員会

委 員 長 ：加柴 良裕（大阪大学）
副委員長：青柳 昌宏（熊本大学）
　　福本 信次（大阪大学）
委　員：
秋山 靖裕((株)東芝)、渥美幸一郎(MTイノベーション)、岩本 知広(茨城大学)、大熊 秀雄((有)エイチ・ティー・オー)、小勝 俊亘(日本電気(株))、戒能 修三(パナソニックホールディングス(株))、久保 雅男(パナソニック(株))、小林 二郎((一財)電子科学研究所)、齋藤 重正((株)GYシステムズ)、嶋田 勇三((一社)日本実装技術振興協会)、菅沼 克昭(大阪大学)、高橋 康夫(大阪大学)、高橋 良和(東北大学)、武井 利泰((株)ジャパンユニックス)、竹本 正(大阪大学)、田中 敏宏(大阪大学)、貫井　孝(京都大学)、廣瀬 明夫(大阪大学)、藤原 伸一((株)日立ハイテク)、松村 慶一(インフィテックエム(株))、南 二三吉(大阪大学)、宮崎 則幸(佐賀大学)、村井 淳一(三菱電機(株))、山本 治彦(FICT(株))、吉田　隆(富士電機(株))

実行委員会

委 員 長 ：作山 誠樹（富士通(株)）
副委員長：荘司 郁夫（群馬大学）
　　西川　宏（大阪大学）
委　員：
青木 豊広(日本アイ・ビー・エム(株))、青木 雄一(エスペック(株))、赤松 俊也(富士通(株))、朝倉 義裕(神戸市立工業高等専門学校)、新井　進(信州大学)、安藤 哲也(室蘭工業大学)、池田　徹(鹿児島大学)、石橋 正朗(凸版印刷(株))、出田 吾朗(三菱電機(株))、市川 大悟((株)タムラ製作所)、井上 雅博(群馬大学)、今井健太郎(群馬大学)、岩田 剛治(大阪大学)、上島　稔((株)ダイセル)、上西 啓介(大阪大学)、上村 泰紀(富士通(株))、海老原伸明(ＮＥＣスペーステクノロジー(株))、岡本 康寛(岡山大学)、小椋 智(大阪大学)、折井 靖光(長瀬産業(株))、鎌田 信雄(化研テック(株))、木村 文信(東京大学)、木村 裕二((株)村田製作所)、葛谷 俊博(室蘭工業大学)、小林 竜也(群馬大学)、小山 真司(群馬大学)、阪元 智朗(オムロン(株))、佐藤 弘((国研)産業技術総合研究所)、佐名川佳治(パナソニック(株))、関本 隆司(日本アビオニクス(株))、瀬知 啓久(東京ブレイズ(株))、髙尾 尚史((株)豊田中央研究所)、高岡 英清((株)村田製作所)、高木 和順(千住金属工業(株))、髙橋 邦夫(東京工業大学)、巽　裕章(大阪大学)、冨岡 泰造((株)東芝)、中田 裕輔(JX金属(株))、濱田 真行((地独)大阪産業技術研究所)、久田 隆史(日本アイ・ビー・エム(株))、平井 維彦(日立Astemo(株))、藤野 純司(三菱電機(株))、松嶋 道也(大阪大学)、松林　良(パナソニックインダストリー(株))、圓尾 弘樹(パナソニックコネクト(株))、満倉 一行(昭和電工マテリアルズ(株))、見山 克己(北海道科学大学)、村山　啓(新光電気工業(株))、森　三樹(華為技術日本(株))、森　貴裕((株)ADEKA)、両角　朗(富士電機(株))、山内　啓(群馬工業高等専門学校)、山口 敦史(パナソニックインダストリー(株))、山中 公博(中京大学)、山根 常幸((株)東レリサーチセンター)、山部 光治((株)東芝)、山本 哲也((株)東芝)、山本 佑樹((株)弘輝)、横沢 伊裕(UBE(株))、若松 栄史(大阪大学)、渡邉　聡(藤倉化成(株))、渡辺　潤(OKIネクステック(株))、渡邉 裕彦(富士電機(株))

＜問合せ先＞
Mate2023事務局
〈あゆみコーポレーション内〉

E-MAIL：mate@a-youme.jp
PHONE：06-6131-6605　FAX：06-6441-2055

First Circular and Call for Papers　論文募集

Mate 2023

29th Symposium on
"Microjoining and Assembly Technology in Electronics"
24-25 Jan. 2023

第２９回
「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

日時：２０２３年 １月２４日(火)，２５日(水)
場所：パシフィコ横浜　会議センター
　　横浜市西区みなとみらい1丁目1-1

主催 ：
(一社)スマートプロセス学会　エレクトロニクス生産科学部会
(一社)溶接学会　マイクロ接合研究委員会

共催：
(一社)エレクトロニクス実装学会
(公社)化学工学会　エレクトロニクス部会
(一社)レーザ加工学会

協賛：
応用物理学会、軽金属学会、精密工学会、電子情報通信学会、
日本機械学会、日本金属学会、日本材料学会、日本溶接協会

（依頼中を含む）

Mate2023

29th Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics”

開催主旨

日本のエレクトロニクス産業は、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた電子デバイス・部品を組み込んだ新たな電子システム創成によって、社会の発展を牽引してきました。さらに今後、持続可能な社会を実現していくためには、技術の科学的探求をベースとしつつ、既存の学問領域や設計・生産技術などの領域を越えて、経営・生産システムや価値システムなどの広い範囲を取り込んだオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムは、エレクトロニクスにおける接合・実装技術をコアとした最新の生産技術に関して、研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

論文募集

独創性に富むオリジナル論文（学術論文、研究開発論文）を募集しております。各講演の発表時間は12分程度を予定しております。投稿希望の方はWEB申込みしていただくようにお願い申し上げます。執筆要項、学術論文、研究開発論文の区分等に関しましては、申込者への通知送付時に投稿規定とともに送付させていただきます。

速報論文募集

最新のデータを公表できる場として、オリジナル速報論文を募集します。2ページの速報論文で申込みが可能です。各講演の発表時間は12分程度を予定しております。投稿希望の方はWEB申込時に速報論文を選択していただくようにお願い申し上げます。

表　彰

本シンポジウムで発表された優秀なオリジナル論文に対してシンポジウム賞（優秀論文賞、奨励賞）、また速報論文および学生の発表に対して表彰制度を用意しております。

カテゴリーA　工　法

A-1	固相接合
A-2	ソルダリング
A-3	ろう付
A-4	溶接
A-5	接着
A-6	ナノプロセッシング
A-7	成膜
A-8	印刷
A-9	ビーム加工
A-10	エッチング
A-11	マイクロ加工
A-12	塑性加工
A-13	システム化・統合化
A-14	その他

カテゴリーB　研究・開発の観点

B-1	金属材料
B-2	有機材料
B-3	複合材料
B-4	加工プロセス
B-5	アセンブリプロセス
B-6	メカニズム・現象解析
B-7	接合・界面構造
B-8	信頼性
B-9	解析・シミュレーション
B-10	機能設計・システム
B-11	熱マネジメント
B-12	設備・機器
B-13	検査・評価
B-14	計測・分析
B-15	生産システム
B-16	その他

カテゴリーC　対象形態・製品

C-1	デバイス
C-2	パッケージ（3D, ウェハレベル等）
C-3	モジュール（パワー）
C-4	モジュール（車載, 光, LED等）
C-5	MEMS・センサー
C-6	実装部品
C-7	基板（PCB, インターポーザ等）
C-8	エネルギー変換機器
C-9	車載機器
C-10	通信・携帯機器, コンピュータ
C-11	光学・表示機器
C-12	医療・バイオ機器
C-13	航空宇宙機器
C-14	その他

申込方法

下記URLに申込みホームページを設けますので、必要事項を記入して申込みを行ってください。

https://sps-mste.jp/mate/

申込締切：2022年8月31日（水）

概要受理決定後、論文発表の場合は4ページ～6ページの論文を提出、また速報論文の場合は2ページの論文を提出してください。なお、論文投稿の流れや論文執筆要項などの詳細はホームページを参照してください。

論文提出締切：2022年11月　4日（金）
速報論文提出締切：2022年11月18日（金）

参加費 *税込み、論文集PDFダウンロード付

	2023/1/5まで	1/6以降
主催団体個人会員	20,000円	22,000円
主催団体シニア会員	10,000円	12,000円
大学・国公立研究機関	20,000円	22,000円
口頭発表者・座長	20,000円	22,000円
主催団体維持・賛助会員	25,000円	27,000円
共催団体会員	25,000円	27,000円
協賛団体会員	30,000円	32,000円
一　般	35,000円	37,000円
学　生	10,000円	12,000円

論文集（冊子）　：5,000円

会　場

パシフィコ横浜　会議センター
＊みなとみらい線　みなとみらい駅より徒歩3分
＊JR線・市営地下鉄　桜木町駅より徒歩12分
＊横浜駅よりタクシー7分、シーバス（船）で10分